

第50回ソルダリング分科会プログラム

日時:平成22年 11月 5日(金) 10:30～15:30

場所:自動車会館 大会議室(東京都千代田区)

主 題 「ソルダリングの注目技術 ―材料からその場観察装置まで―

	時 間	題 目	講 演 者
平成 22 年 11 月 5 日 金 曜 日	10:30～ 11:50	司会 折井 靖光 (日本アイ・ビー・エム(株))	
		『パワー半導体素子実装における 鉛はんだ代替技術』 (40 分)	(株)東芝 研究開発センター ○高橋利英
		『炭素を添加した鉛フリーはんだ』 (40 分)	メタル・アンド・テクノロジー(株) ○伊地知基義 (株)白金 田島 匠 筑波大学名誉教授 大嶋建一
	11:50～ 13:00	昼 食 休 憩	
	13:00～ 13:10	分 科 会 議 事	
	13:10～ 14:30	司会 出田 吾朗 (三菱電機(株))	
		『大型高密度製品の鉛フリーに対応した 「静圧方式はんだ付け技術」』 (40 分)	(株)センスビー ○武田登志夫、山本茂明、 小池尚也
		『定量、安定、高品質用挿入部品の 自動はんだ付け機』 (40 分)	(株)PARAT ○中 眞一郎
	14:30～ 14:50	休 憩	
	14:50～ 15:30	司会 高田 隆 (パナソニック(株))	
		『微小チップ部品(0603、0402 サイズ)の はんだぬれ性評価』 (40 分)	(株)レスカ 開発部 ○藤間貞行

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。